

半導體工程系 進修部四技 110 學年度入學課程結構規劃表

| 課程類別 | | 一年級 | | | | | | 二年級 | | | | | | 三年級 | | | | | | 四年級 | | | | | |
|---------|---|------------------------|-------------|----|----------|-----|----------------------|----------------|----------|----------------------|---------------|---------|----------------|--------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------|---------|-----|----|
| | | 第一學期 | | | 第二學期 | | | 第一學期 | | | 第二學期 | | | 第一學期 | | | 第二學期 | | | 第一學期 | | | 第二學期 | | |
| | | 課程名稱 | 學分數 | 時數 | 課程名稱 | 學分數 | 時數 | 課程名稱 | 學分數 | 時數 | 課程名稱 | 學分數 | 時數 | 課程名稱 | 學分數 | 時數 | 課程名稱 | 學分數 | 時數 | 課程名稱 | 學分數 | 時數 | 課程名稱 | 學分數 | 時數 |
| 校共同必修課程 | 應修學分數 10 學分 | 實務應用文 | 2 | 2 | 大學國語文 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 實用英文(一) | 2 | 2 | 實用英文(二) | 2 | 2 | 實用英文(三) | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 體育(一) | 0 | 2 | 體育(二) | 0 | 2 | 體育(三) | 0 | 2 | 體育(四) | 0 | 2 | | | | | | |
| 通識課程 | 博雅通識 應修學分數 10 學分 (5 大課群 至少任選 3 課群) | 美感與人文素養 | 博雅通識/學分數/時數 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 科技與環境永續 | 博雅通識/學分數/時數 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 社會與知識經濟 | 博雅通識/學分數/時數 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 歷史與多元思維 | 博雅通識/學分數/時數 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 全球與未來趨勢 | 博雅通識/學分數/時數 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 跨課群認列 | 通識微學分(一)1、通識微學分(二)1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 專業課程 | 必修 應修課程數 20 門/ 應修學分數 60 學分 | 微積分(一) | 3 | 3 | 微積分(二) | 3 | 3 | 電子學(一) | 3 | 3 | 電子學(二) | 3 | 3 | 半導體元件 | 3 | 3 | 微電子專題 | 3 | 3 | 單晶片實驗 | 3 | 3 | | | |
| | | 電路學(一) | 3 | 3 | 電路學(二) | 3 | 3 | 微電子電路實驗 | 3 | 3 | 半導體材料概論 | 3 | 3 | 半導體製程 | 3 | 3 | FPGA/HDL 設計實習 | 3 | 3 | | | | | | |
| | | 普通物理 | 3 | 3 | 數位邏輯實務 | 3 | 3 | 電腦輔助 電路設計實習 | 3 | 3 | 微電子應用 電路實驗 | 3 | 3 | 半導體量測實驗 | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| | | 計算機概論 (Office 軟體應用) | 3 | 3 | 計算機與程式應用 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 專業課程 | 選修 應修學分數 至少選修 48 學分 | 普通物理實驗 | 3 | 3 | 電腦網路概論 | 3 | 3 | 微控制器實務應用 | 3 | 3 | 半導體封裝工程 | 3 | 3 | 嵌入式系統實習 | 3 | 3 | 統計學 | 3 | 3 | 自動控制 | 3 | 3 | VLSI 設計 | 3 | 3 |
| | | | | | | | 電腦數值控制 CAD/CAM 實習 | 3 | 3 | 工程數學 | 3 | 3 | 數位系統 應用實務 | 3 | 3 | 真空系統 | 3 | 3 | 感測元件應用 電路實習 | 3 | 3 | 數位訊號處理 | 3 | 3 | |
| | | | | | | | 電腦網路概論 | 3 | 3 | 電腦數值控制 CAD/CAM 實習 | 3 | 3 | IC 產業 介紹與應用 | 3 | 3 | 物聯網產業 介紹與應用 | 3 | 3 | 感測網路 應用實務 | 3 | 3 | 光電元件量測 暨封裝實務 | 3 | 3 | |
| | | | | | | | | | 虛擬圖控儀表實務 | 3 | 3 | 太陽能光電技術 | 3 | 3 | 半導體封裝可靠 度分析 | 3 | 3 | 發光二極體 元件及其應用 | 3 | 3 | 大數據資料庫 應用實務 | 3 | 3 | | |
| | | | | | | | | | | | 半導體封裝工程 | 3 | 3 | 數位訊號處理 | 3 | 3 | 半導體封裝可靠 度分析 | 3 | 3 | 半導體封裝元件 EMI/EMC 分析 | 3 | 3 | | | |
| | | | | | | | | | | | 電磁學 | 3 | 3 | 虛擬圖控 儀表實務 | 3 | 3 | 半導體封裝元件 EMI/EMC 分析 | 3 | 3 | 工業經濟學 | 3 | 3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 工業經濟學 | 3 | 3 | 產業經濟學 | 3 | 3 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 嵌入式系統實習 | 3 | 3 | 訊號與系統 | 3 | 3 | | | | | | |

備註：

- 一、畢業總學分數為 128 學分。
- 二、專業課程必修 60 學分，專業課程選修 48 學分。(不含校共同必修課程及通識課程的學分數)
- 三、校共同必修課程及通識課程 20 學分；相關規定依據本校「共同教育課程實施辦法」、「共同教育課程結構規劃表」及「語言教學實施要點」。
- 四、系所訂定條件(學程、檢定、證照、承認外系學分及其他)：承認外系選修學分 9 學分為專業選修(本院非本系開設之專業選修課程至多承認 6 學分，非本院開設之專業選修課程至多承認 3 學分)

